

股票代碼：3580

友威科技 營運簡報

Date：114/12/24

投資人關係聯絡方式：

E-mail：theresachen@uvat.com

UVAT
Vacuum Ecosystems

會議流程

01

公司沿革

02

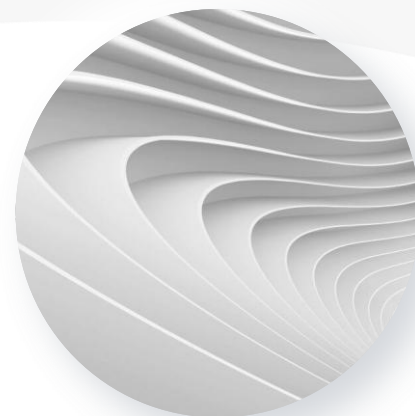
技術分享與產品

03

經營實績

04

未來展望

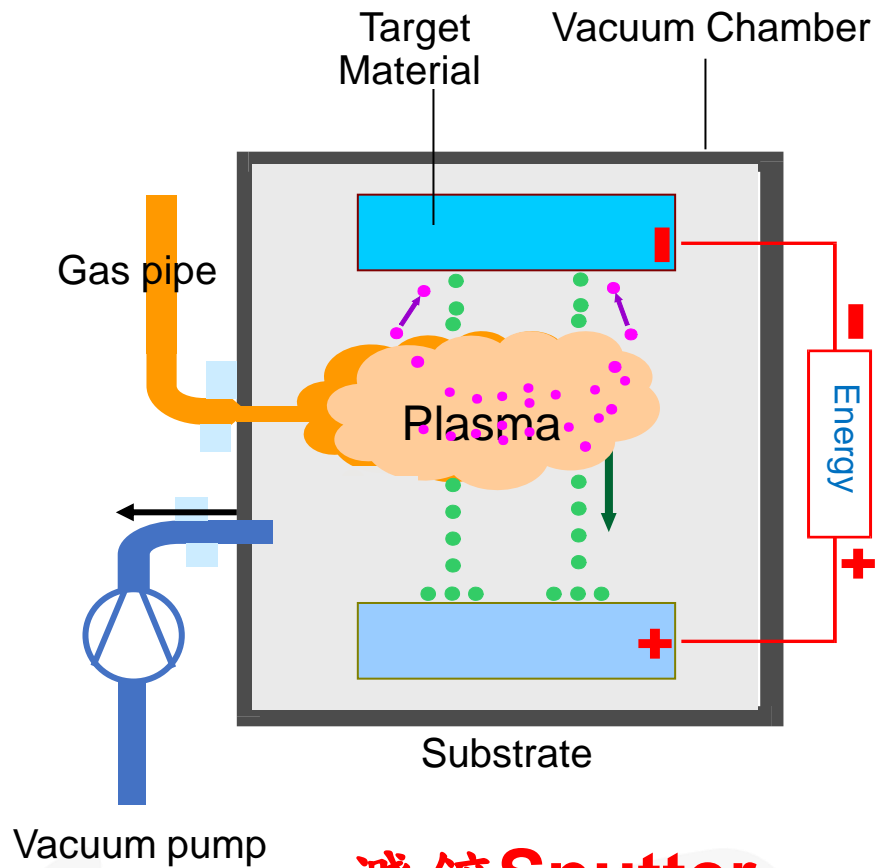




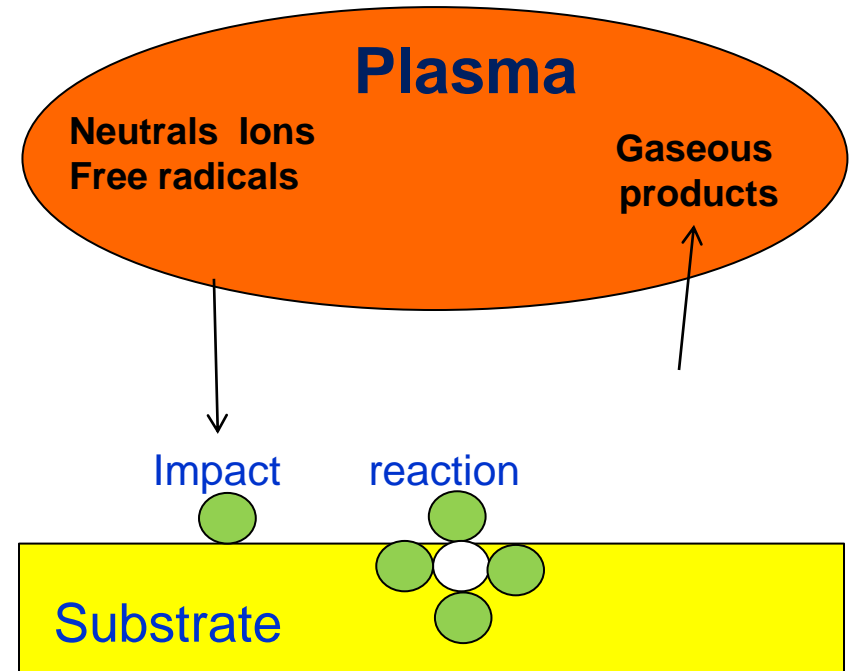
01

公司沿革

乾式(Dry)製程的解決方案



濺鍍 Sputter



電漿蝕刻 Plasma Etch

友威的核心

乾式Dry
真空製程

濺鍍
Sputtering

蝕刻
Etching

ESG
綠色製程
環保製程

薄型化
薄膜化

關於友威

| | |
|------|--|
| 成立時間 | 2002/11/04 |
| 董事長 | 李原吉 |
| 資本額 | 新台幣3億9,470萬 |
| 員工 | 台灣：120人 海外：約150人 |
| 服務項目 | 真空濺鍍設備 蝕刻設備 半導體設備及相關耗材 鍍膜代工 光學鍍膜 薄膜元件 |



- ❖ 2007年股票公開發行
- ❖ 2008年**Forbes**亞太200大最佳中小企業
- ❖ 2010年7月9日股票上櫃(友威科3580)

營運據點



■ 台灣

- 位址：台中
 - 研發中心
 - 設計中心
 - 設備製造
 - 客戶服務



- 位址：桃園
 - 濺鍍代工
 - 客戶服務



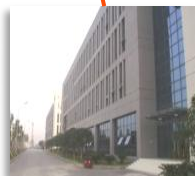
■ 馬來西亞

- 位址：麻坡Muar
 - 客戶服務
 - 業務拓展



■ 中國

- 位址：重慶
 - 濺鍍代工
 - 客戶服務



- 位址：深圳
 - 濺鍍代工
 - 客戶服務

里程碑

2002-2012

2012-2017

2017-2022

2022~

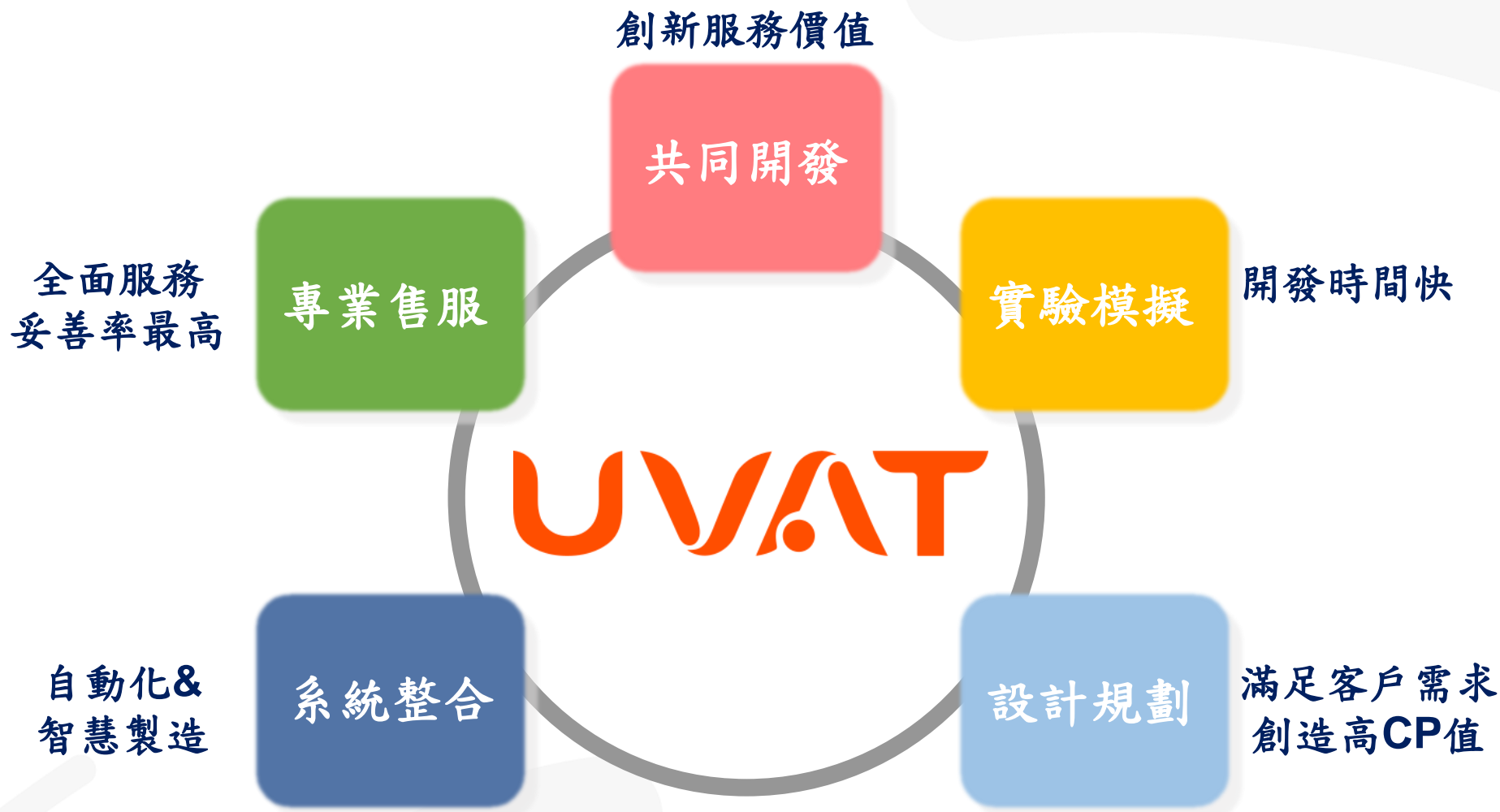


Sputter

Etch

Semi

核心價值及服務



台灣精品獎

UVAT

產業類別：生產力&能源精品

產品型號：鈦銅種子層濺鍍機

連續式真空濺鍍機



台灣精品 2021
TAIWAN EXCELLENCE



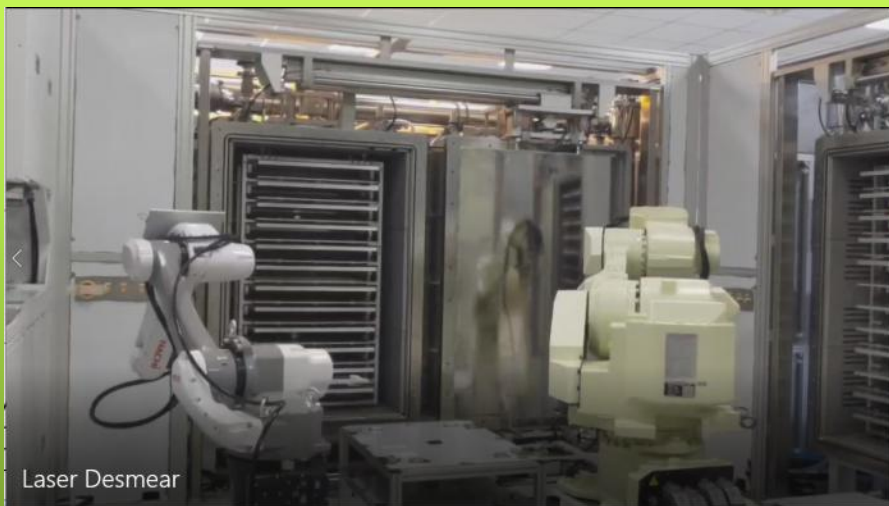
蝕刻 Dry Etch



第九屆經濟部
國家產業創新獎

經濟部—
中小企業創新研究獎

- Panel level plasma treatment



- High aspect ratio plasma descum



- Fine pitch metal etch



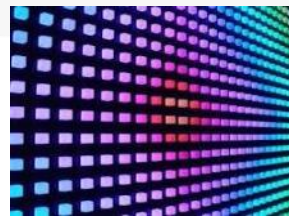
產品應用的市場



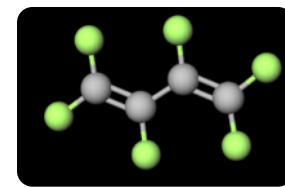
汽車



光學
產業



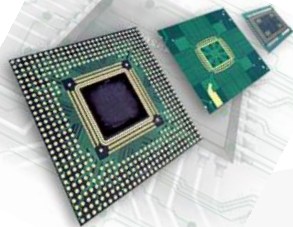
石英產業



消費性
電子

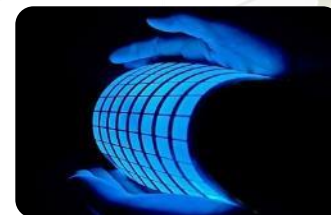


IC 載板
電路板

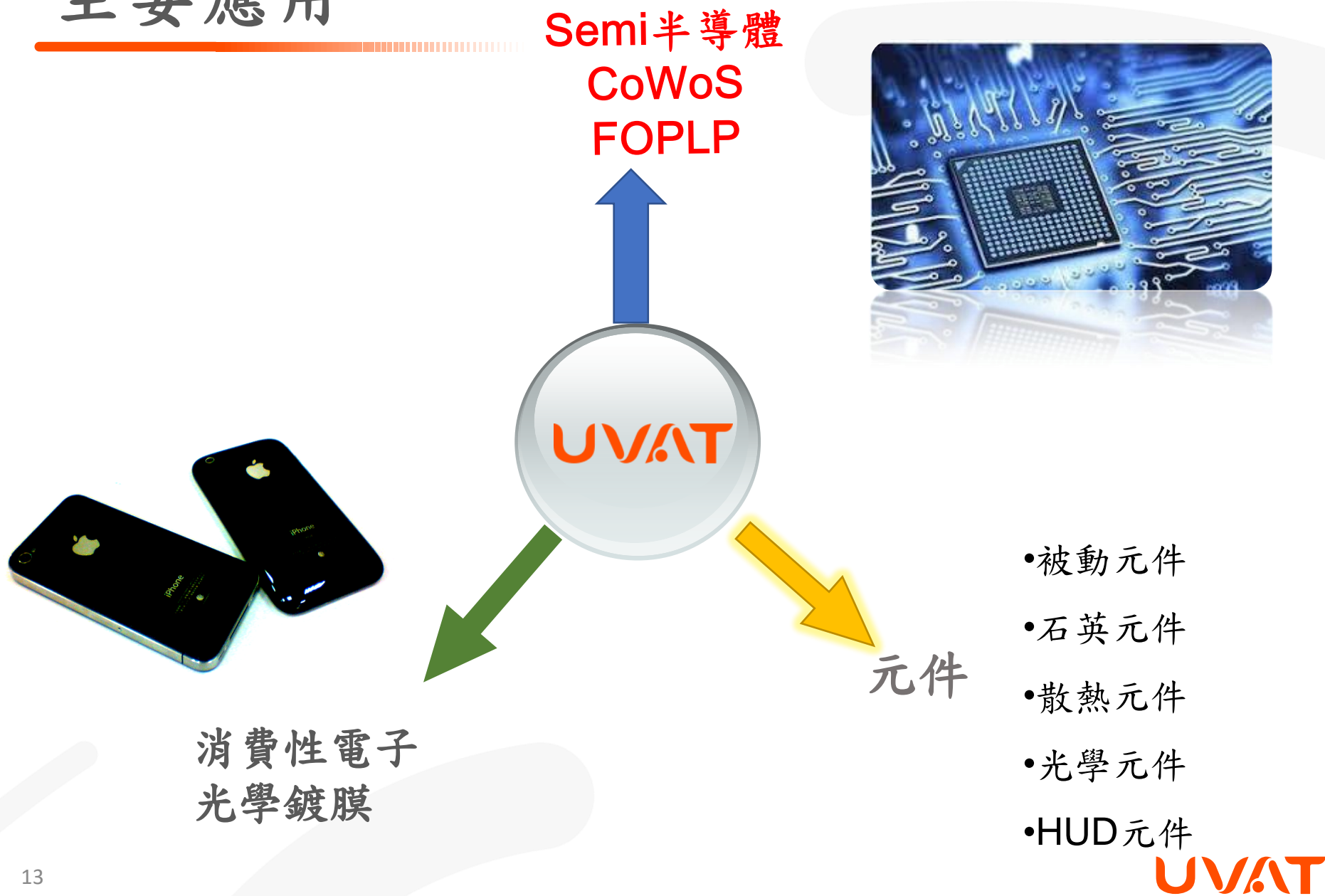


晶片內埋

半導體封裝



主要應用





02

技術分享與產品

小孔徑除膠渣 Small Via Desmear

■ 目的

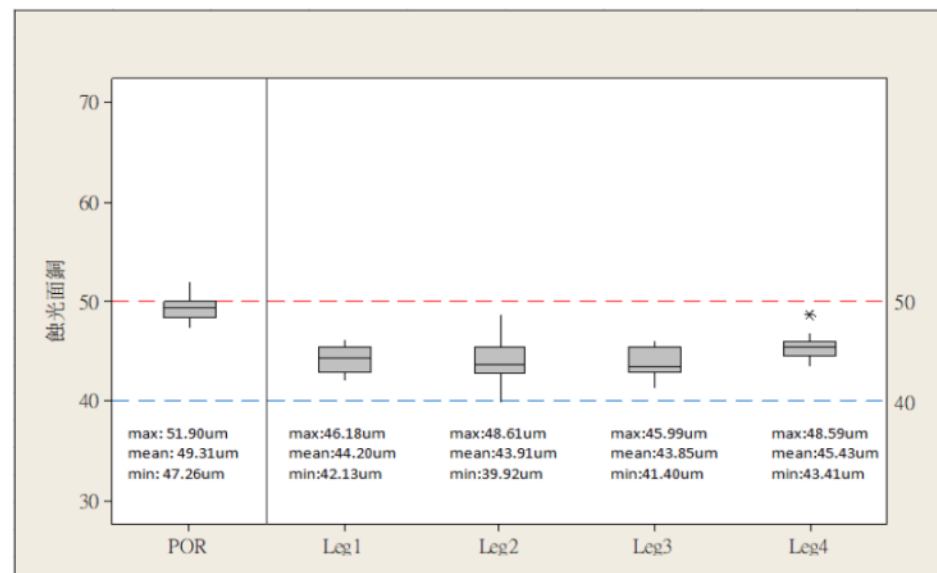
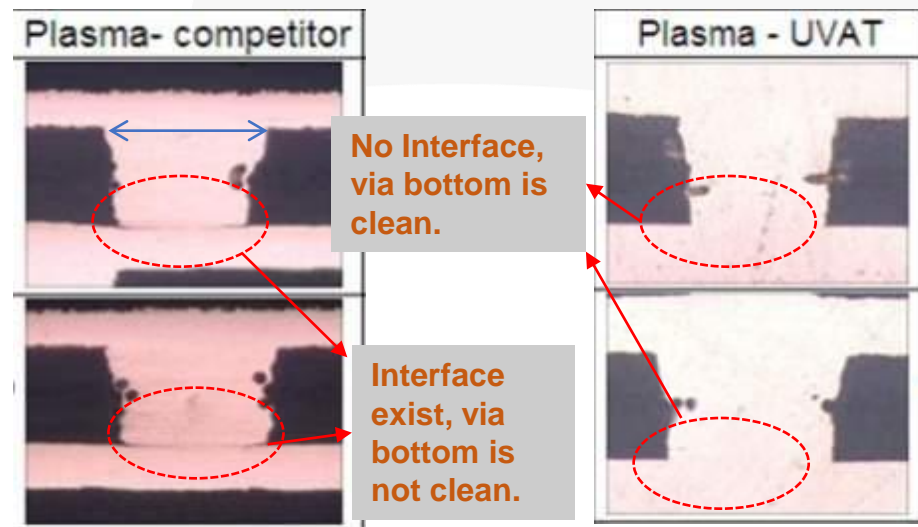
- PP Desmear
- 電鍍後孔底殘留確認

■ Film structure 開窗規格

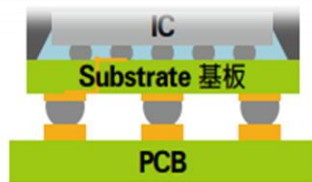
- Pattern width : 40um
- Pattern high : 40um

■ 測試結果

- 蝕刻機可完全移除PP材料
- 透過SEM檢測確認

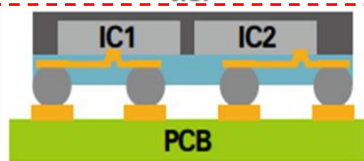


高階封裝應用_FOPLP

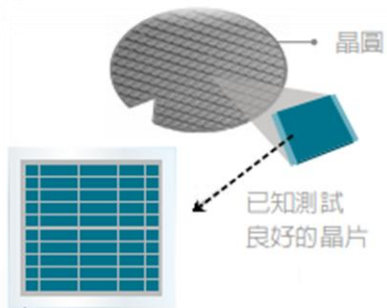
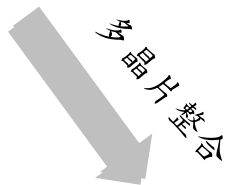
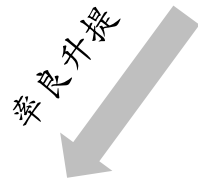


覆晶封裝

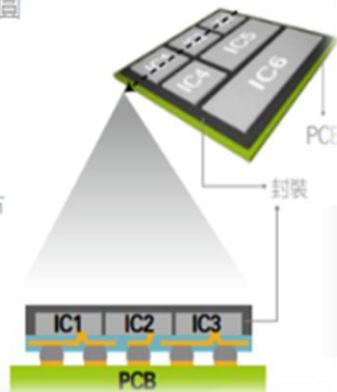
V.S.



扇出型封裝



透明玻璃、電路板
或其他半導體材料



中高階載板供應不足下，驅使無載板、可
一次性大面積封裝且有效降低製造成本的
面板級封裝 **FOPLP** 應用備受矚目。

優勢：

- 挑出良好IC 進行封裝，提升良率
- 多晶片異質晶片整合
- 縮小封裝體積
- 大面積封裝降低成本

玻璃基板Glass Core及 TGV

Plasma for RDL

表面改質/孔底清潔

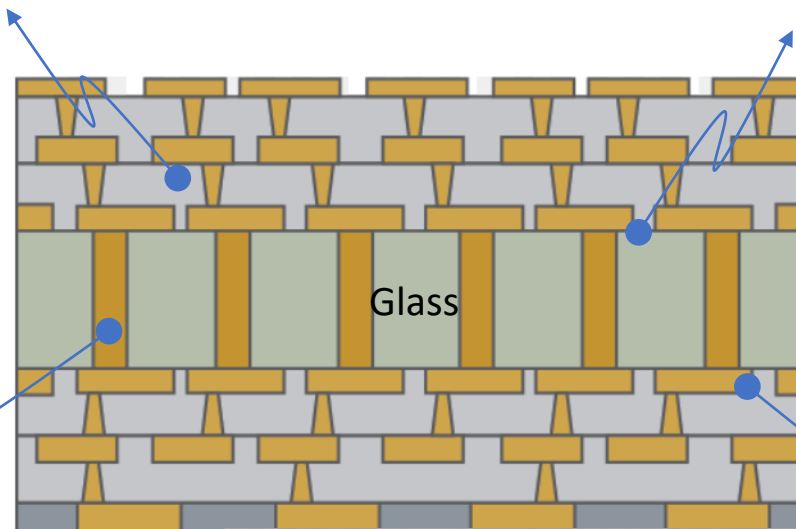
PE-01 Series

PE-02 Series

PE-03 Series

PE-01 Series

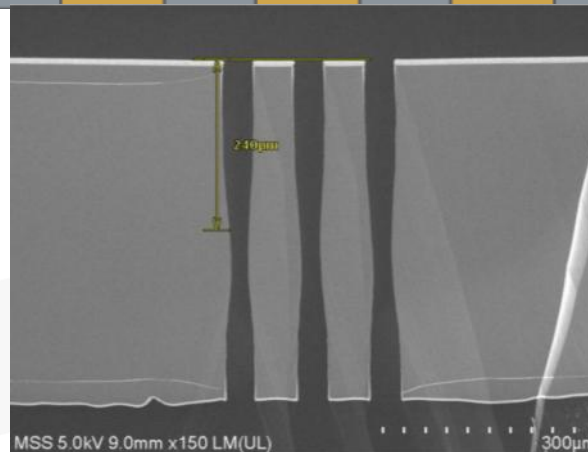
電漿表面改質



PE-02 Series



玻璃鑽孔
(Glass Via Drilling)



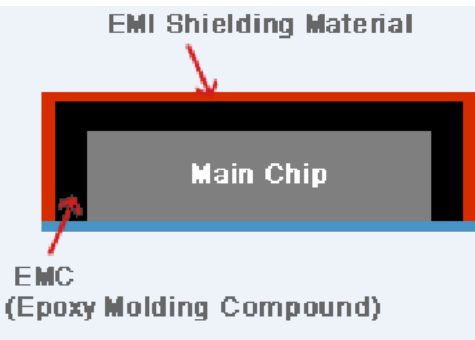
種子層鍍膜_Ti/Cu



Advanced Package

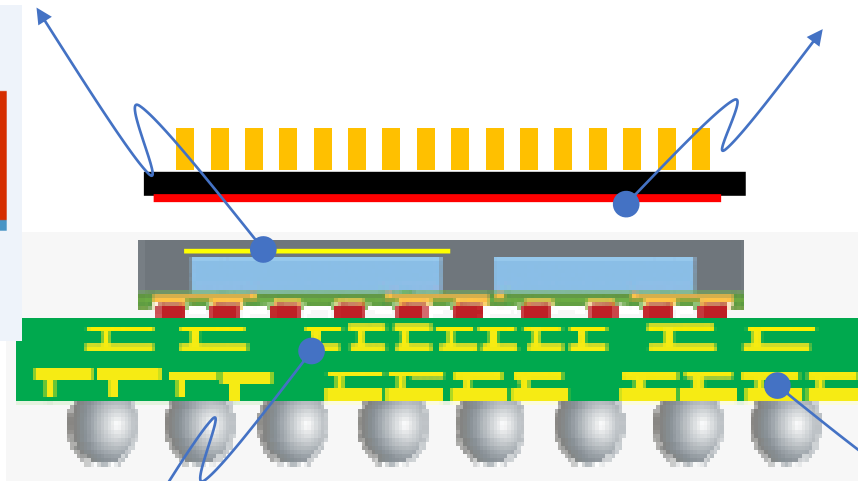
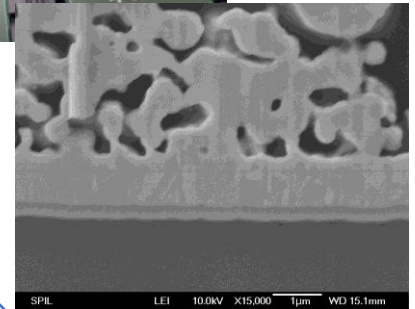
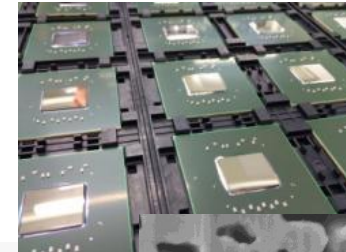
SIP EMI

SUS/Cu/SUS



Thermal Dissipation

Ti/NiV/Ag, Ti/NiV/Au



Plasma Etcher

- Ti/Cu Seed Layer Dry Etch
- Plasma Descum
- Plasma Pre-treatment



Seeding Sputter

Ti/Cu

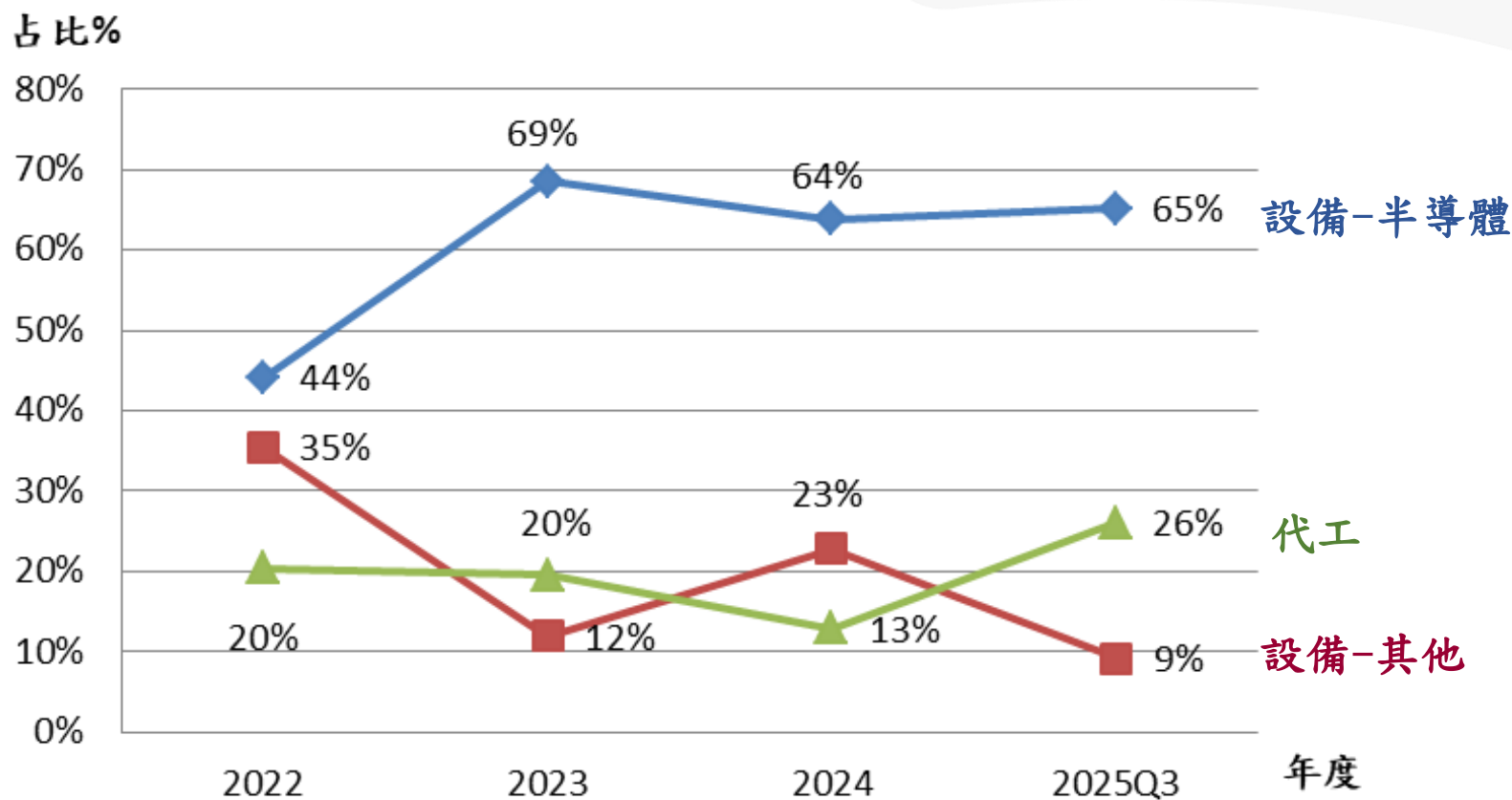




03

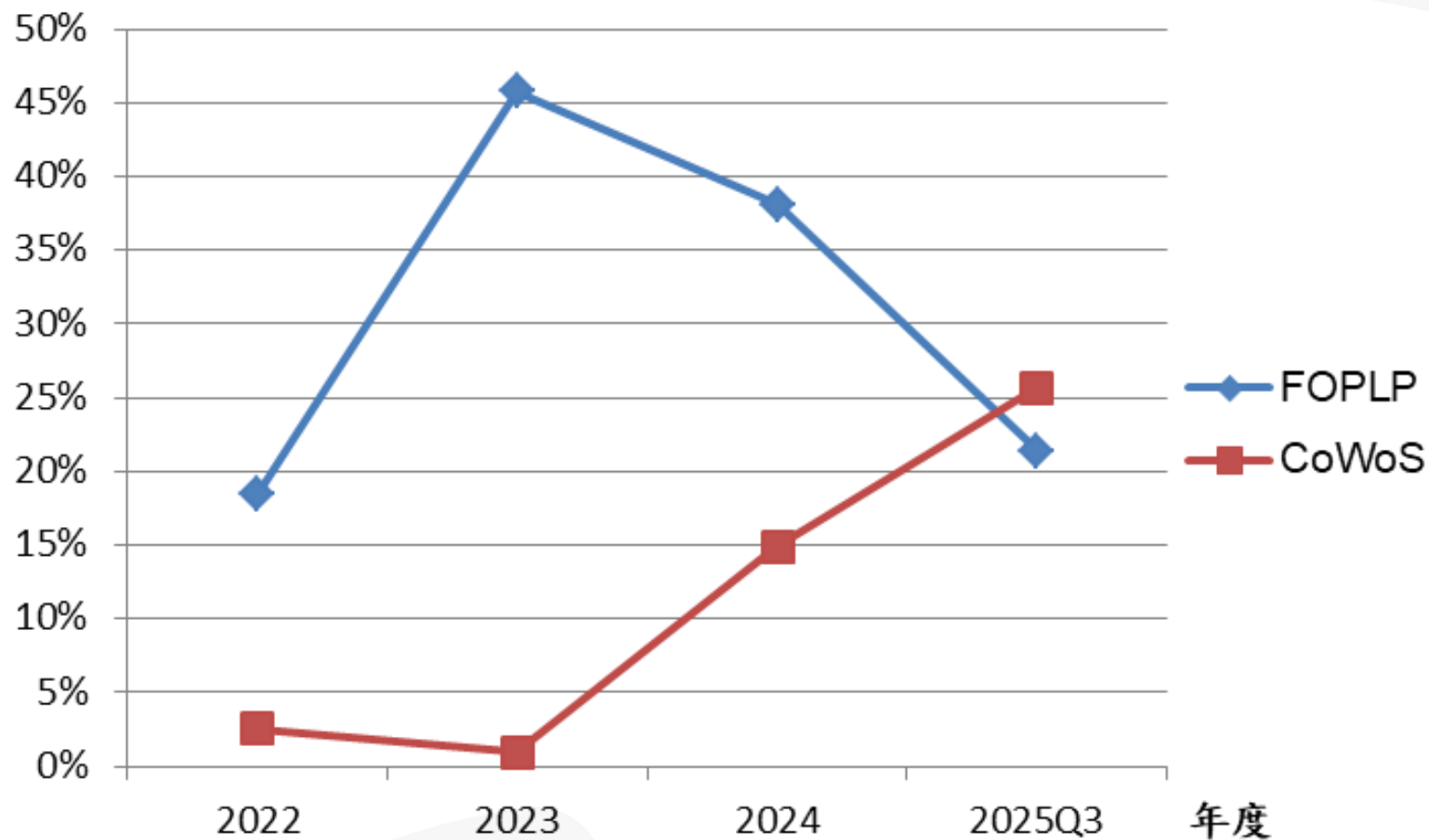
經營實績

2022~2025Q3產品占比趨勢



★2025年設備營收占比達74%，其中半導體設備達65%

2022~2025Q3 FOPLP及CoWoS 占比趨勢



★2025年CoWoS營收占比首度超越FOPLP產品

2022~2025Q3簡明損益表

單位：NTD仟元

| 年度 | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % | 2025Q3 | % |
|------|-----------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| 營業收入 | 1,038,477 | 100% | 744,579 | 100% | 660,171 | 100% | 317,797 | 100% |
| 營業成本 | 561,008 | 54% | 433,846 | 58% | 374,054 | 57% | 157,039 | 49% |
| 營業毛利 | 477,469 | 46% | 310,733 | 42% | 286,117 | 43% | 160,758 | 51% |
| 營業費用 | 200,726 | 19% | 187,679 | 25% | 187,655 | 28% | 88,515 | 27% |
| 營業淨利 | 276,743 | 27% | 123,054 | 17% | 98,462 | 15% | 72,243 | 23% |
| 稅前淨利 | 328,355 | 32% | 133,343 | 18% | 132,618 | 20% | 71,786 | 23% |
| 稅後淨利 | 247,299 | 24% | 102,216 | 14% | 198,176 | 30% | 57,439 | 18% |
| EPS | 6.37 | | 2.63 | | 5.08 | | 1.46 | |

04

未來展望

重大資本支出-企業總部

- 地點：台中市大雅區(鄰近中科)
- 預計正式投產時間：2026年第三季
- 預計產能：現有產能5倍以上
- 綠建築/智慧建築
- 擴大半導體研發中心

德鑫半導體聯盟



德鑫/德鑫貳半導體控股大艦隊18家公司合影留念

德鑫：鄭智文、王年清、關聖哲、吳騰彥、邱銘乾、黃銘文、吳明致、周傳華

德鑫貳：林文彬、李傳德、朱明癸、詹文雄、莊明郎、林守堂、陳勳森、簡榮坤、洪誌宏、李原吉

2025年2月26日於台北



布局美國及日本



免責聲明

- ◆ 本簡報及同時發布之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運展望、財務狀況及業務預測等內容，係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。
- ◆ 本公司未來實際產生之營運結果、財務狀況與業務成果，可能與預測市場及資訊需求、價格、波動、競爭之風險等因來，包括但不限於匯率波動、國際經濟狀況、匯率波動、國際經濟狀況、匯率波動。
- ◆ 本簡報中所提供之資訊，係反映本公司截至目前為止對未來之看法，並未明示或暗示其具有正確性、完整性或可靠性。對簡報內容，未來若有變更或調整，本公司或不負責任或修正。
- ◆ 未經本公司允許情況下，不可複製、修改、重新編譯、刪減或傳送本簡報任何內容，或將任何該等內容作為商業用途。



Vacuum Ecosystems

Thank you

友威科技股份有限公司
UVAT Technology Co., Ltd.

